



EMI 和 EMC 解决方案 > EMI 屏蔽层 > EMI 密封圈 > 标准 MIL-DTL-38999 系列 III 连接垫片



密封圈类型: EMI 连接器密封圈

成品类型: 导电薄板

粘合材料: 氟硅橡胶

填充材料: 镀银铝（银/铝）

产品厚度: .8 mm [.031 in]

[所有 标准 MIL-DTL-38999 系列 III 连接垫片 \(36\)](#)

产品特性

产品类型特性

成品类型	导电薄板
粘合材料	氟硅橡胶
填充材料	镀银铝（银/铝）

电气特征

耐石油	是
体积电阻率（最大值）	.012 Ω.cm

主体特性

密封圈类型	EMI 连接器密封圈
-------	------------

尺寸

产品厚度	.8 mm[.031 in]
产品宽度	34.32 mm[1.351 in]

使用环境



工组温度范围	-55 – 160 °C[-67 – 320 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

与连接器外壳尺寸兼容	17
------------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 超过限值的SVHC： DCP (.32% in Component) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

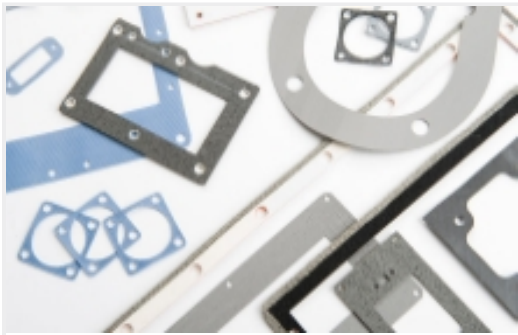
配套部件



该系列中的其他产品 | [Kemtron 93 系列](#)



EMI 密封圈(152)



医用 EMI 垫片(76)

文档

产品图纸

Conn G FSA 38999 S3 Shell 17

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_2428000-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2428000-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2428000-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Performance Materials brochure

英文版本

Connector Gaskets for RFI/EMI Shielding

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本